

第 47 回国際電子回路産業展 JPCA2017 の展示会のご案内

会期:2017 年 6 月 7 日(水)~9(金)

開催場所: 東京ビッグサイト

【ブース番号: 東 6 ホール 6E-10】

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度は弊社では「第 47 回国際電子回路産業展 JPCA2017」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。展示予定装置は下記の通りです。

第 47 回国際電子回路産業展 JPCA2017 展示予定装置・テクノロジー

1. 高精密・高精度を要求される複雑な PCB・FPC を非接触、メカニカルストレスを与えずクリーンなカットが可能なレーザー基板分割機・外形加工機
「LPKF MicroLine 2000 シリーズ」(実機展示)
2. 日本国内で 2000 台以上の販売実績。迅速な試作基板加工を卓上型サイズの装置で実現「LPKF ProtoMat S63」(実機展示)
3. 迅速かつ高品質なメタルマスクが実現可能なステンシル・レーザー装置
「LPKF StencilLaser G 6080」(実機展示)
4. 半導体チップの接続に使用されるガラスインターポーザ向けの精密なスルーホール加工を実現できる TGV 超高速レーザー加工装置
「LPKF Vitrion® 5000」(加工サンプル展示・テクノロジーご案内)
5. 従来の PCB・FPC ではできなかった 3 次元回路(=MID)について、採用メリット(小型化・基板レス・部品点数削減等)をご案内
「LPKF-LDS®工法」(加工サンプル展示・テクノロジーご案内)

展示会でのご面談のご希望の方は下記に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信いただきますようお願い申し上げます。

敬具

LPKF Laser& Electronics 株式会社

【マーケティング担当: 高橋寛規】

【03-5439-5906】

【<http://jp.lpkf.com>】

=====アポイントメントシート=====

【返信先 FAX: 03-5439-5908】 【返信先 E-mail: hiroki.takahashi@lpkf.com】

必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信ください。

御社名:

お名前:

部署・役職:

E-mail:

ご来場予定日時:2017 年 6 月 7 日(水)・8 日(木)・9 日(金) _____ 時頃希望

※10 時~17 時まで開催しております。※ご希望時間に沿えない場合はご連絡いたします。

ご興味のある製品などまた現状抱えている課題などございましたら下記にてご記入ください。

()